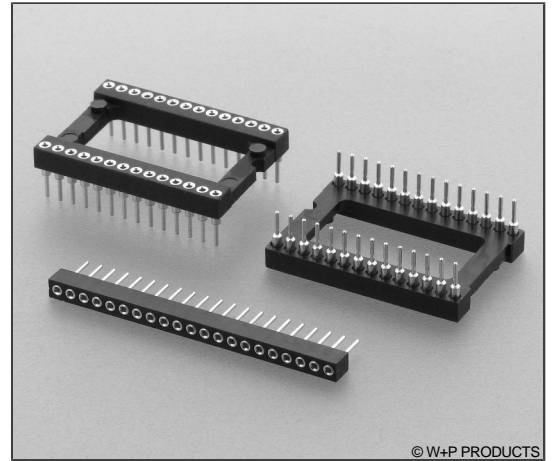


Technische Daten / Technical Data

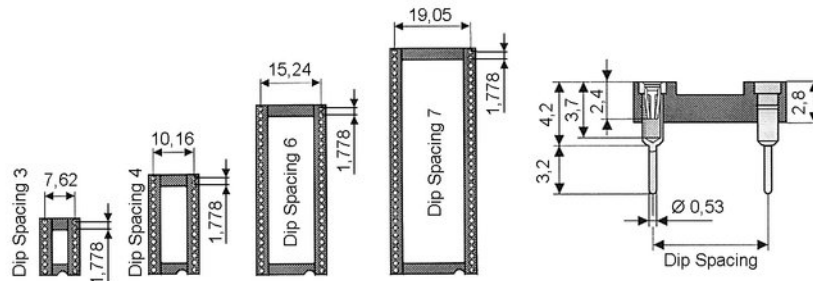
Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass</i> <i>Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Contact Material	
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{RMS}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



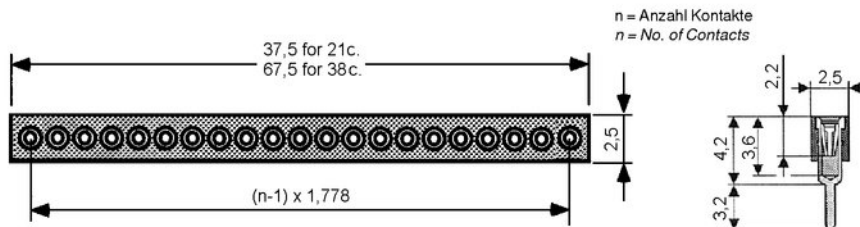
© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.

IC-Fassung Serie 326 IC-Socket Series 326



IC-Leiste Serie 327 IC-Strip Series 327



n = Anzahl Kontakte
n = No. of Contacts

Series 326 326 IC-Fassung IC-Socket	Contacts* 16 16 =====> 28/30/32/48 =====> 20/24/28/40/42/48/ 50/52/56/64/68=====> 64 =====>	DIP-Spacing* 3 3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 7 19,05mm	Sleeve Plating 50 50 Verzinkt (Standard) Tin plated (Standard)	Clip Plating* 00 00 Vergoldet Gold plated 10 Vergoldet 0,25µm (Option) 0,25µm gold plated (Option) 30 Vergoldet 0,75µm 0,75µm gold plated
Series 327 327 IC-Leiste IC Header	Contacts* 21 21/38 Einreihig Single row	Rows 1 1 Einreihig Single row	Sleeve Plating 50 50 Verzinkt (Standard) Tin plated (Standard)	Clip Plating* 00 00 Vergoldet Gold plated 10 Vergoldet 0,25µm (Option) 0,25µm gold plated (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

